

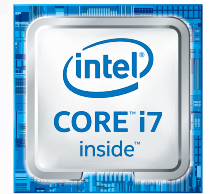
タイニータワー

Q170チップセット

1 PCI-E x16シグナル

2 PCI-E x4シグナル

日本製電源



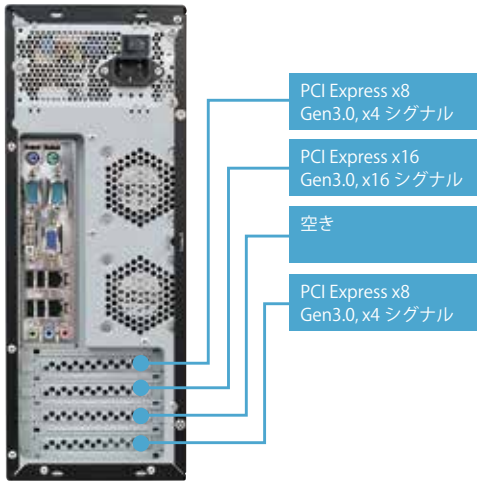
IPC-S170SSZ-TY

〔供給終了時期:2021年ごろ〕

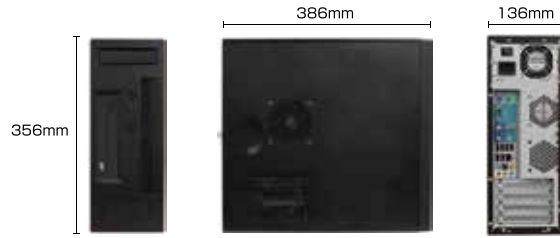


- 医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格 ISO13485に準拠したマザーボードを採用
- 省スペース筐体にフルハイトボードが搭載可能
- 第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーが搭載可能
- 組み込み用途向けチップセット インテル® Q170を搭載
- 最大64GBメモリーまで搭載可能
- 遠隔地からのリモート監視・制御を可能にするIPMI搭載
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成
- 信頼性の高い日本製電源を採用

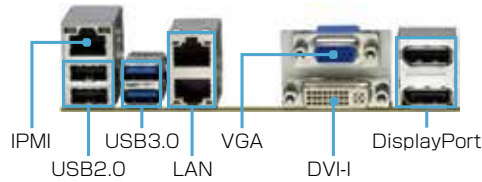
■ 拡張スロット構成



■ 外観寸法図



■ I/Oポート構成



■ 製品仕様

プロセッサ	種類	第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサ 第6世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ 第6世代 インテル® Core™ i3 プロセッサ インテル® Pentium® プロセッサ インテル® Celeron® プロセッサ
	搭載数	1
チップセット		インテル® Q170 Express チップセット
メモリー	規格	DDR4 2133/1866/1600MHz
	最大容量	64GB
	スロット数	4
ストレージ	5インチベイ	1
	3.5インチベイ	3 (内部2)
	SATAコネクタ数	4 (SATA3.0)
グラフィックス		インテル® HD Graphics & ASPEED AST2400 BMC ※インテル社のCPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサの種類により異なります
I/O	DVI-I	1
	Display Port	2
	VGA	1 (IPMI用ASPEED AST2400 BMC)
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0)
	LAN	2 (GbE)
	IPMI	1 (ver 2.0)
拡張スロット	PCI Express x16	1 (x16シグナルGen3.0)
	PCI Express x8	2 (x4シグナルGen3.0)
外形寸法		W136mm × D386mm × H356mm (突起物等を除く)
電源		日本製電源
		310W (連続最大容量) / 400W (ピーク容量)
利用環境	入力電圧	AC90V ~ 240V
	温度	10°C ~ 35°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10°C ~ 55°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)



HPCシステムズ株式会社

CTO事業部

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階

TEL: 03-5446-5535 / FAX: 03-5446-5550

http://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv logo、Intel vPro、Intel vPro logo、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2016年8月1日現在の内容です。